

레노버 고밀도 서버 포트폴리오

고밀도 솔루션

"소프트웨어 정의" 데이터 센터 시대에 고객들은 더 높은 밀도와 더 쉬운 확장성과 함께 더 나은 경제성을 갖춘 플랫폼을 찾고 있습니다. 고객의 IT 예산은 항상 빠듯했기 때문에 동일 면적 내에 가능한 많은 연산 능력을 갖추기 위한 고밀도와 매일 발생하는 대량의 데이터를 수용할 수 있는 확장성 및 더 나은 경제성이 필요합니다.

기존보다 저렴한 IT 비용 및 효율적인 에너지 관리로 컴퓨팅, I/O, 스토리지 및 GPU와 같은 다양한 기능을 고밀도 성능과 함께 제공하여 데이터 센터의 상면 및 냉각 비용과 전력 절감 효과를 가져옵니다.

레노버 고밀도 서버는 데이터 센터를 위한 보다 뛰어난 성능, 효율성 및 유연성을 제공하며, 다양한 워크로드를 위한 광범위한 서버 기능의 선택이 가능합니다.

고밀도 서버 구축 시 주요 이점은 다음과 같습니다.

- 고밀도 컴퓨팅 성능을 제공하여 비용을 최적화하는 "가장 기본적인" 플랫폼
- 성능 저하 없이 전력과 냉각 비용 절감
- 유연한 혼합 구성과 단순한 아키텍처를 사용하여 GPU나 보조 프로세서를 통해 집약적인 컴퓨팅
- 고밀도 스토리지 또는 최대 4개의 GPU 등, 모든 워크로드 요구사항을 단일 플랫폼에서 해결

NeXtScale

SD650 & n1200 DWC 엔클로저

SD650 & n1200 DWC 엔클로저



SD530 & D2 엔클로저

레노버 NeXtScale System

뛰어난 확장성과 향상된 성능

NeXtScale System은 초고밀도의 확장형 플랫폼으로 가용 밀도를 극대화하는 획기적인 접근 방식을 제공합니다. 유연성이 필요한 클러스터링된 고성능 워크로드 처리를 최적화하여 더욱 신속하게 깊이 있는 정보를 제공할 수 있습니다. 기술 컴퓨팅에서 그리드 구축, 분석 워크로드, 대규모의 클라우드 및 가상화 인프라에 이르기까지 다양한 응용 프로그램을 처리할 수 있는 단순하지만 강력한 시스템입니다.

레노버 ThinkServer sd530 + D2 엔클로저

엔클로저 엔터프라이즈 및 클라우드 워크로드를 위한 경제적 초고밀도 2U 4노드 플랫폼

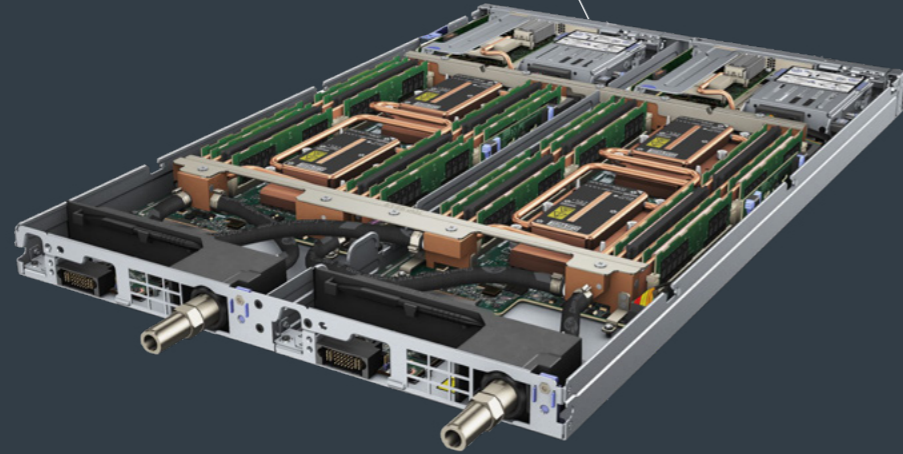
레노버 ThinkServer sd530 + D2 엔클로저의 2U4N 시스템은 적은 공간 소비 및 기본적인 고밀도 구성으로 인해 솔루션 기반 어플라이언스를 낮은 비용으로 구축하는 데 이상적인 대안이기 때문에 대기업부터 서비스 공급업체까지 다양한 데이터 센터에서 자주 이용되고 있습니다. 엔터프라이즈, 클라우드, HPC 및 하이퍼 결합 솔루션을 위해 최적화된 sd530은 오늘날 가장 빠른 인텔 프로세서를 사용해서 최적의 메모리 및 스토리지 용량을 제공하여 저렴한 비용으로 뛰어난 성능 및 확장성을 지원합니다.



인텔® 제온®
플래티넘 프로세서

Lenovo NeXtScale System Line up

ThinkSystem SD650 **Direct Water Cooled Server**



ThinkSystem SD650	
폼 팩터	1U 풀 와이드 트레이 더블 노드 / 6U12N Chassis
프로세서	노드당 2x 인텔® 제온® Scalable Family, Gold or Platinum level 프로세서 지원 (최대 28코어, 3.9GHz, 205W TDP등급) 인텔® Omni path 패브릭이 내장된 F-suffix 지원
메모리(표준 / 최대)	노드당 12x DIMM 소켓 (CPU당 6DIMMs) 지원 최대 1.5 TB 메모리 (12x 128 GB 3DS RDIMMs) Lenovo TruDDR4 RDIMM, LRDIMM 및 3DS RDIMM이 지원.
스토리지	2x 7mm SATA SSD 1x 15mm SATA SSD or NVMe SSD (SATA HDD with special Bior) 2x M.2 SATA SSD
NIC	1x 1 GBaseT, 1x 1 GbE XCC dedicated
확장슬롯	1x x16 PCIe F / EDR Infiniband, HDR과 내부 x16 1x x16 ML2 for 10Gbit 이더넷 내부: 1x x8 for RAID, 1x x16 for pot. expansions
전원 공급 장치	1300W / 1500W / 2000W Platinum and 1300W Titanium
USB 포트	최대 1x front via dongle cable + 1x internal (2.0)
쿨링	PSU 팬 (No Fans on chassis) 최대 50°C의 따뜻한 물이 냉각 시스템을 통해 순환되어 부품 냉각
시스템 관리 도구	XCC, 전용포트 or shared TPM, 플러그식 TCM

NeXtScale n1200 엔클로저	
폼 팩터	6U NeXtScale, 표준 랙
베이	12개의 절반 너비 베이
전원 공급 장치	- 최대 6개의 핫 스왑 전원 공급 장치 (900W or 1300W or 1500W) - 900W: 200V-240V or 100V-127V에서 작동 - 1300W / 1500W: 200V-240V에서만 작동 - 추가 옵션으로 이중화 (N + 1 or N + N)된 80 PLUS Platinum or 80 PLUS Titanium 인증된 파워 서플라이 제공 - 후면에 샷시 설치 - 싱글 파워 도메인 모든 서버에 전원 공급
팬	Tool이 별도로 필요없는 10개의 핫 스왑 듀얼 로터 80mm 시스템 팬 디자인



인텔® 제온®
플래티넘 프로세서

Lenovo ThinkSystem SD530 Line up

ThinkServer Sd530



ThinkSystem SD530	
폼 팩터	2U 랙 엔클로저, 4개의 개별 컴퓨팅 노드
프로세서	최대 2개 인텔® 제온® Platinum 프로세서, 최대 165W
메모리(표준 / 최대)	최대 1TB, 16x 슬롯 (64GB DIMM 사용), 2666MHz TruDDR4
확장 슬롯	D2 인클로저당 1개 서플 : x8 PCIe Shuttle - 8x PCIe 3.0 x8 슬롯 (노드당 2개) 또는 x16 PCIe Shuttle -4x PCIe 3.0 x16 슬롯 (노드당 1개) 최대 2개 외부 1U 트레이 (각 노드당 최대 2개 GPU)
최대 내부 스토리지	최대 24x (노드당 6x) HS SFF SAS / SATA HDDs / SSD, 최대 8x (노드당 2x) HS SFF NVMe SSD
네트워크 인터페이스	선택 사항 8포트 E10M 10Gb SFP+ (노드당 2개 포트) 선택 사항 8포트 E10M 10Gb BaseT RJ45 (노드당 2개 포트)
전원 공급 장치 (표준 / 최대)	2X 핫 스왑 / 중복 구성 1+1 1600W / 2000W 또는 1x 비중복 구성 1100W
핫스왑 구성요소	전원공급장치, 팬, SAS / SATA / NVMe 스토리지 장치, 컴퓨팅 노드는 워밍업 가능
RAID 지원	SW RAID가 JBOD, Entry RAID 지원, 선택 사항 HW RAID 12Gb JBOD, plus M.2 부트 지원 (선택 사항 RAID)
시스템 관리	XClarity Controller 임베디드 관리, XClarity Administrator 중앙 인프라 제공, XClarity Integrator 플러그인 및 XClarity Energy Manager 중앙 서버 전원
지원되는 운영 체제	Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere. 자세한 내용은 lenovopress.com/osig 를 참조하십시오.
제한 보증	3년 고객 교체 가능 유닛 (CRU) 및 현장 서비스, 다음 영업일 응답 (주 5일 9시간 근무), 서비스 업그레이드 옵션

D2 엔클로저	
폼 팩터	2U 랙 마운트 샷시
베이	4개의 풀 베이
전원 공급 장치	최대 2개의 핫 스왑 전원 공급 장치 (1100W or 1600W or 2000W) - PSU 200V - 240V AC, 50 or 60Hz 필요 - 1100W: 100V - 127V AC 50 or 60Hz 지원 - 후면에 샷시 설치 80 PLUS Platinum 과부하 및 서지 프로텍션 보호 기능 내장장치
팬	엔클로저 탑 커버의 이동식 패널을 통해 액세스 할 수있는 5개의 핫스왑 시스템 팬